

中国电子节能技术协会

关于征求《半导体设备高分子材料零部件焊接加工技术规范》标准意见的通知

各有关单位：

根据中国电子节能技术协会制修订项目计划，标准起草组已完成《半导体设备高分子材料零部件焊接加工技术规范》（项目编号：JH/T/DZJN53-2024）团体标准征求意见稿的编制工作。按照我会《团体标准制修订程序》的要求，现在公开征求意见。

请各有关单位认真研究，将意见填入“意见反馈表”中，于 2025 年 8 月 13 日前，以电子邮件方式反馈至以下联系人。涉及修改重要技术指标时，请附上必要的技术数据。逾期未复函的按无异议处理。

联系人：王忠会 电 话： 13718985727 010-57423205

电子邮件： zgdzjnjsxh1986@163.com

附件1：《半导体设备高分子材料零部件焊接加工技术规范》征求意见稿及编制说明

附件 2：意见反馈表

